

国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026—024

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	中信建投：张玉龙、王大林、黄杨璐
时间	2026年6月12日
地点	国机精工会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：赵祥功 投资者关系助理：汪智婷
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p style="text-align: center;">1. 问：超硬材料磨具业务在半导体领域的开展情况？</p> <p>答：近几年，得益于我国半导体产业的发展，公司应用在半导体领域的产品保持较快增长势头。产品种类上，金刚石工具类已覆盖倒边轮、减薄砂轮、划片刀、封装刀等产品类型，精密陶瓷制品类已覆盖陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等产品类型。</p> <p style="text-align: center;">2. 问：公司精密陶瓷制品业务的情况？</p> <p>答：公司在半导体领域精密陶瓷产品上处于行业领先地位，该产品包括陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等。应用在半导体领域的精密陶瓷制品，技术开发难度大，产品技术壁垒较高，市场前景好，是公司未来几年重点推广的产品，公司将加快其市场导入，持续提升市场占有率。</p> <p style="text-align: center;">3. 问：金刚石散热主流产品类型及市场如何比较？</p> <p>答：行业内主流产品分为单晶金刚石散热片、多晶金刚石散热片和金刚石铜复合材料三大类。单晶金刚石散热片热导率约 2000W/m·K 以上；多晶金刚石散热片的热导率约 1500W/m·K；金刚石铜复合材料热导率约 800W/m·K。市场主要从生产成本、生产工艺、下游适配场景等维度综合评估。</p> <p style="text-align: center;">4. 问：公司在金刚石散热领域的产品布局和进展？</p>

	<p>答：目前，金刚石散热片和金刚石光学窗口片已有小批量订单，主要供应国防工业领域，2025 年实现收入超 1000 万元。</p> <p>在散热领域，公司已形成覆盖金刚石单晶、金刚石多晶及金刚石铜复合材料的产品矩阵。产业化进展方面，CVD 金刚石产品（含单晶与多晶）已进入行业头部客户的验证阶段；金刚石铜复合材料已向重点客户送样验证。在民用散热领域，各技术路线产品目前均处于下游客户验证阶段，如果进展顺利，年内有望有小批量订单的商业化落地。</p> <p>5. 问：公司金刚石散热产品是否还存在降本空间？</p> <p>答：一方面，公司的新疆哈密产业园规划用于合成金刚石，利用当地低价电能降低成本；另一方面，推进全产业链技术迭代，包括晶种片、设备、沉积工艺、加工环节的技术创新来进一步降低成本。</p> <p>6. 问：公司机器人轴承业务进展如何？</p> <p>答：公司已将机器人轴承纳入“十五五”业务板块规划，未来重点聚焦高附加值产品，如交叉滚子轴承等</p> <p>7. 问：公司未来规划是怎么样的？</p> <p>答：在轴承领域，推动空间执行部件更好服务我国商业航天发展，满足配套商业航天重点主机需求；拓展人形机器人用轴承，重点开发交叉滚子轴承等高附加值产品。在超硬材料领域，加速迈入金刚石功能化应用时代，优化金刚石铜复合材料、突破大尺寸光学级金刚石产品、加速第四代半导体材料研发。商业航天轴承、人形机器人轴承、金刚石散热片和金刚石光学窗口片，这些产品，将成为公司塑造第二增长曲线的主力军，有望在 3-5 年内形成公司新的利润增长点。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>